

GX112X WLCSP 封装、兼容 SMBus 和 I²C 通信的低功耗数字温度传感器

1 基本性能

- **多芯片访问**（Multiple Device Access, **MDA**）
——全局读写操作
- 测温范围: **-55°C ~ +150°C**
- 测温精度: **±0.15°C (+30°C ~ +45°C)**
±0.5°C (-40°C ~ +125°C)
- 封装: **4-Ball WLCSP**
4-Pin MCLGA
4-Ball Fan out
- 电源电压: **1.4V ~ 5.5V**
- 低静态电流
正常工作: **≤5μA (1Hz)**
≤10μA (4Hz)
关断模式: **≤1μA**
- 分辨率: **0.0625°C**
- 数字输出: **兼容SMBus、I²C接口**

2 应用场景

- 手机
- 笔记本电脑
- 固态硬盘（SSDs）
- 服务器
- 机顶盒
- 低功耗环境
- 传感器

3 芯片概述

GX112X是一款高精度、低功耗、可替代NTC / PTC热敏电阻的数字温度传感器，可用于通信、计算机、消费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。GX112X在-40°C至+125°C的正常工作范围内，可提供≤±0.5°C的温度精度，并具有良好的温度线性度。GX112X可提供扩展测温模式，将测温范围扩展为-55°C至+150°C。

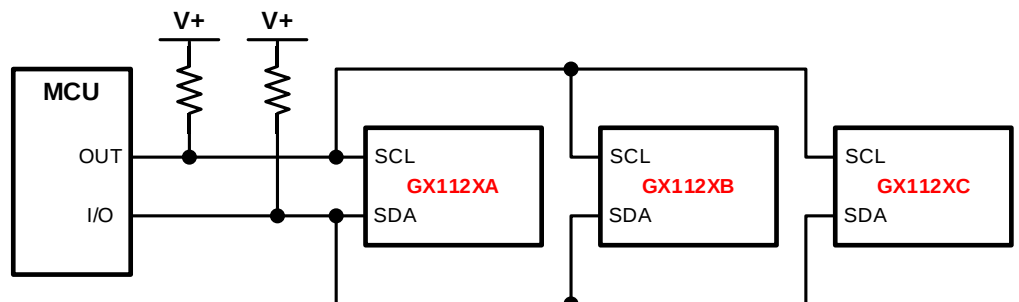
GX112X的额定工作电压范围为1.4V~5.5V，在整个工作范围内最大静态电流为10μA（测温频率4Hz）。集成在芯片内部的12位ADC分辨率低至0.0625°C。

GX112X采用0.725mm×0.725mm 4-Ball晶圆级封装。GX112X的两线接口兼容SMBus和I²C通信方式，并支持多芯片访问（MDA）命令，允许主机同时与总线上多个芯片进行通信，而无需向每个芯片单独发送读写命令。GX112X支持在主线上同时挂载16个不同地址的芯片。

芯片信息

产品编号	封装信息	芯片主体面积
GX112X	WLCSP (4)	0.725 mm × 0.725 mm
GX112XT	MCLGA (4)	3.00 mm × 3.00 mm
GX112XF	Fan out (4)	0.85 mm × 0.85 mm

GX112X 应用框图



9 订购信息

订购编号	芯片型号	封装信息	标准包装数量	备注
GX112XA-T&R	GX112XA	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XB-T&R	GX112XB	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XC-T&R	GX112XC	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XD-T&R	GX112XD	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XE-T&R	GX112XE	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XF-T&R	GX112XF	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XG-T&R	GX112XG	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XH-T&R	GX112XH	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XI-T&R	GX112XI	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XJ-T&R	GX112XJ	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XK-T&R	GX112XK	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XL-T&R	GX112XL	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XM-T&R	GX112XM	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XN-T&R	GX112XN	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XO-T&R	GX112XO	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XP-T&R	GX112XP	WLCSP	3000	卷带包装
GX112XTE-Tr	GX112XTE	MCLGA	490	Tray 盘
GX112XFA-T&R	GX112XFA	Fan out	3000	卷带包装
GX112XFD-T&R	GX112XFD	Fan out	3000	卷带包装
GX112XFE-T&R	GX112XFE	Fan out	3000	卷带包装